06 Двухстадийное легирование кремния изотопами фосфора и серы-32

© Ш. Махкамов, Н.А. Турсунов, М. Каримов, А.Р. Саттиев, М. Ашуров, М. Эрдонов, Х.М. Холмедов

Институт ядерной физики АН Республики Узбекистан, Ташкент E-mail: makhkamov@inp.uz

Поступило в Редакцию 30 октября 2007 г.

Предложен принципиально новый подход к получению твердых источников примеси серы для диффузионного легирования кремния двухстадийным методом, позволивший устранить эрозию поверхности полупроводниковых пластин. Суть этого подхода заключается в превращении радионуклида ³² P, продиффундировавшего в приповерхностную область кремния после первой стадии диффузии (загонка), в изотоп ³² S.

Показано, что в образцах кремния, легированных изотопом ³²S, появляются глубокие уровни с энергиями ионизации E_c – 0.13, E_c – 0.25, E_c – 0.37 и E_c – 0.50 eV донорного характера, обусловленными примесью серы.

Установлено, что диффузия изотопа серы в p-Si приводит к изменению типа проводимости материла, а в n-Si снижает величину удельного сопротивления ρ .

PACS: 66.30.Jt, 71.55.Cn

Получение легированных полупроводниковых материалов и приборов на их основе, обладающих наперед заданными и стабильными свойствами, представляет большой интерес в современной твердотельной электронике.

В этом отношении особая роль принадлежит быстродиффундирующим глубокоуровневым примесям, введения которых позволяют регулировать в широком пределе основные параметры материалов и улучшать их электрофизические, фотоэлектрические и другие свойства. К числу этих примесей относится сера. Кремний, легированный серой, подробно исследован в ряде работ [1–5]. Первые результаты по Si $\langle S \rangle$ получены Карлсоном [1]; и показано, что при введении серы в кремний образуются два донорных уровня E_c -0.18 и E_c -0.37 eV [1]. В других работах сообщается об образовании уровней: E_c -0.135 (0.19), E_c -0.285 (0.35), E_c -0.277 (0.325), E_c -0.476 (0.546) eV [2,3]; E_c -0.13,

69

 $E_c - 0.257$, $E_c - 0.36$, $E_c - 0.5 \text{ eV}$ [4,5]. При этом предполагается, что уровни $E_c - 0.13$ и $E_c - 0.257 \text{ eV}$ обусловлены жестко связанными атомами S, расположенными в узле решетки Si. B [4] также показано, что эффективность образования уровней серы $E_c - 0.36$ и $E_c - 0.50 \text{ eV}$ зависит от скорости последиффузионного охлаждения и наличия упругих деформаций и связана с различными зарядовыми состояниями комплекса междоузельный атом серы–вакансия.

Однако введение серы в кремний традиционным методом из паровой фазы неизбежно вызывает эрозию его поверхности. Это обстоятельство не позволяет провести диффузию серы в эпитаксиальный кремний для создания пленочных фоторезисторов. Используемые при этом другие методы, например диффузия из нанесенного на поверхность кремния растворенных атомов в толуоле [4,5], также малоэффективны, так как в этом случае не достигается высокая однородность легирования тонких слоев кремния, а степень легирования ограничивается содержанием серы в растворе.

В данной работе нами предложен принципиально новый подход к созданию источника примеси серы для диффузионного легирования кремния двухстадийным методом, позволивший устранить эрозию поверхности материала атомами серы и достичь высокой степени легирования.

Суть этого подхода заключается в превращении радионуклида 32 P, продиффундировавшего в приповерхностную область кремния после первой стадии диффузии (загонка), в изотоп 32 S по реакции путем β -распада

$${}^{32}\mathrm{P}\frac{\beta^-}{14.5\,\partial ay} \to {}^{32}\mathrm{S} \tag{1}$$

с последующей диффузией ³²S (разгонка) в объем кремния.

Для проведения исследований были отобраны образцы кремния *n*- и *p*-типа проводимости с концентрацией примеси фосфора и бора от $4 \cdot 10^{13}$ до $5 \cdot 10^{15}$ cm⁻³. В качестве диффузанта использован радионуклид ³²P, полученный по стандартной технологии путем облучения особо чистой серы нейтронами спектра деления на атомном реакторе BBP-CM с мощностью 10 MW в течение 400 h по реакции ³²S(*n*, *p*)³² P [6].

Диффузия (загонка) радионуклида ³²Р осуществлялась на воздухе из нанесенного на поверхность диффузанта при температурах 1100 ÷ 1250°С. Время диффузии варьировалось в пределах 5 ÷ 10 h.

Одновременно при тех же температурах была проведена диффузия серы для контрольных образцов из полимерных источников.

Электрофизические параметры образцов до и после легирования измерялись на стандартной установке Холла. Энергетическое положение уровней определялось методом DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) в интервале температур $80 \div 400$ К в режиме постоянного напряжения при временном окне с $t_1 = 50 \,\mu$ s и $t_2 = 5t_1$, где t_1 и t_2 — интервал времени, при котором измеряется разность емкости $\Delta C = C(t_2) - C(t_1)$ [7]. Для емкостных измерений из легированного кремния изготовлялись сплавные p-n-переходы путем плавления Au + 0.1 %Sb с одной стороны и Al с другой в вакууме 10^{-4} Torr при 700°C в течение 1-2 min.

На всех исследуемых образцах были сняты концентрационные кривые распределения радионуклида ³²Р по глубине пластин. Концентрация определялась по результатам измерения удельной электропроводности последовательно снимаемых с образца слоев четырехзондовым методом

$$C\mu = \frac{1}{4.5} \frac{1}{\Delta lq} \left(\frac{I_1}{V_1} - \frac{I_2}{V_2} \right),$$
 (2)

где C — концентрация носителей заряда; μ — их подвижность; q — заряд; Δl — толщина снимаемого слоя; I_1 и I_2 — значения тока, протекающего через образец до и после снятия слоя; V_1 и V_2 — значения напряжения на зондах до и после снятия слоя.

Проведенные измерения удельного сопротивления диффузионного слоя показали, что при этом радионуклид ³²P в зависимости от времени загонки на первой стадии диффузии проникает на $10 \div 20 \,\mu$ m (рис. 1, кривая 2). Распределение концентрации радионуклида ³²P в образованном при этом диффузионном слое можно рассматривать как диффузию из постоянного источника в полуограниченное тело, которое хорошо подчиняется закону (рис. 1, кривая *I*)

$$N(x,t) = N_0 \operatorname{erfc} \frac{x}{2\sqrt{Dt}},\tag{3}$$

где N_0 — поверхностная концентрация радионуклида ³²P или ³²S; N(x, t) — концентрация радионуклида ³²P или ³²S на глубине x после t h диффузионного отжига; D — коэффициент диффузии радионуклида ³²P или ³²S.



Рис. 1. Распределение концентрации радионуклида ³²Р и ³²S по толщине кремния после диффузии при 1100°C в течение 5 h: *1, 2* — распределение радионуклида ³²Р; *3, 4* — распределение ³²S; *1, 3* — расчетная; *2, 4* — экспериментальная.

Далее после выдержки нескольких периодов полураспада изотопа ³²Р проводилась вторая стадия диффузии (разгонка) ³²S при тех же условиях. После удаления с поверхности фосфорсодержащего оксида электрическими и емкостными методами контролировались концентрации ³²S. Кривые распределения концентрации ³²S приведены на рис. 1. Расхождения расчетных значений концентрации ³²S (рис. 1, кривая 3) и измеренных величин (рис. 1, кривая 4) обусловлены тем, что измеренная концентрация примеси серы соответствует только ионизованным уровням серы в кремнии из ядерно-превращенного радионуклида ³²P.

На рис. 2 представлен спектр DLTS p-n-структур, изготовленных из кремния, легированного изотопом ³²S. Как видно из рисунка, на спектре DLTS появляются четыре пика, обусловленные глубокими уровнями с энергиями ионизации E_c – 0.13; E_c – 0.25; E_c – 0.37 и E_c – 0.50 eV донорного характера. Сопоставление значений этих уровней с литературными данными показали хорошее согласие.



Рис. 2. Спектр DLTS $p^+ - n - n^+$ -структур, изготовленных из кремния, легированного примесью серы-32 при температуре 1100°С. $A - E_c - 0.13$ eV; $B - E_c - 0.25$ eV; $C - E_c - 0.37$ eV; $D - E_c - 0.50$ eV.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, что предложен новый радиационно-термический способ однородного легирования кремния изотопом серы из раствора радионуклида фосфор-32, исключающий эрозию его поверхности. Данный способ позволит провести диффузию серы и в эпитаксиальный кремний и может найти широкое применение в технологии изготовления пленочных фоторезисторов, работающих в инфракрасной области спектра излучения.

Список литературы

- [1] Carlson R.O., Hall R.N., Pell E.M. // J. Phys. Chem. Solids. 1959. V. 8. P. 81-86.
- [2] Кирюхин А.Д., Григорьев В.В., Зуев А.В., Зуев В.В., Королев Н.А. // ФТП.
 2007. Т. 41. В. 3. С. 269–272.
- [3] Pensl G., Roos G., Holm C., Wagner P. Defects in Semiconductors / Ed. H.J. Bardeleben. Materials Science Forum. Switzerland, 1986. V. 10–12. P. 911– 916.

- [4] Юнусов М.С., Каримов М., Оксенгендлер Л., Юсупов А. // ФТП. 1997. Т. 31.
 В. 6. С. 708–711.
- [5] Махкамов Ш., Турсунов Н.А., Хакимов З.М., Ашуров М., Эрдонов М., Саттиев А.Р. // Ядерная и радиационная физика. Материалы 4 Межд. конф. Алматы, Казахстан, 15–17 сентября 2003 г. ИЯФ НЯЦ РК, 2004. Т. II. С. 170– 181.
- [6] Маслов И.А., Лукницкий В.А. Справочник по нейтронному активационному анализу. Л.: Наука, 1971. С. 37.
- [7] Берман Л.С., Лебедев А.А. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках. Л.: Наука, 1981. С. 43.